



勢流科技

partner

SIEMENS

Digital Industries Software

2024年2月15日

JESD 51-31 Thermal Test Environment Modifications for MultiChip Packages



Jim



PID 精密儀器事業部



jim@flotrend.com.tw



JESD 51-31 Thermal Test Environment Modifications for MultiChip Packages

- 使用情境:
 - JESD51-31是由JEDEC JC15委員會編製，目的在使用JESD51系列規範中，針對具有多熱源的多晶片封裝指定的熱測試環境條件做適當的修正
- 優點:
 - 透過本文可了解JESD51系列規範針對具有多熱源的多晶片封裝指定的熱測試環境條件做那些適當的修正





勢流科技

partner

Digital Industries Software

SIEMENS

欲知詳情，請加入勢流會員 即可每月收到會員電子報

會員電子報請至客戶專區→會員專屬月刊 觀看完整內容





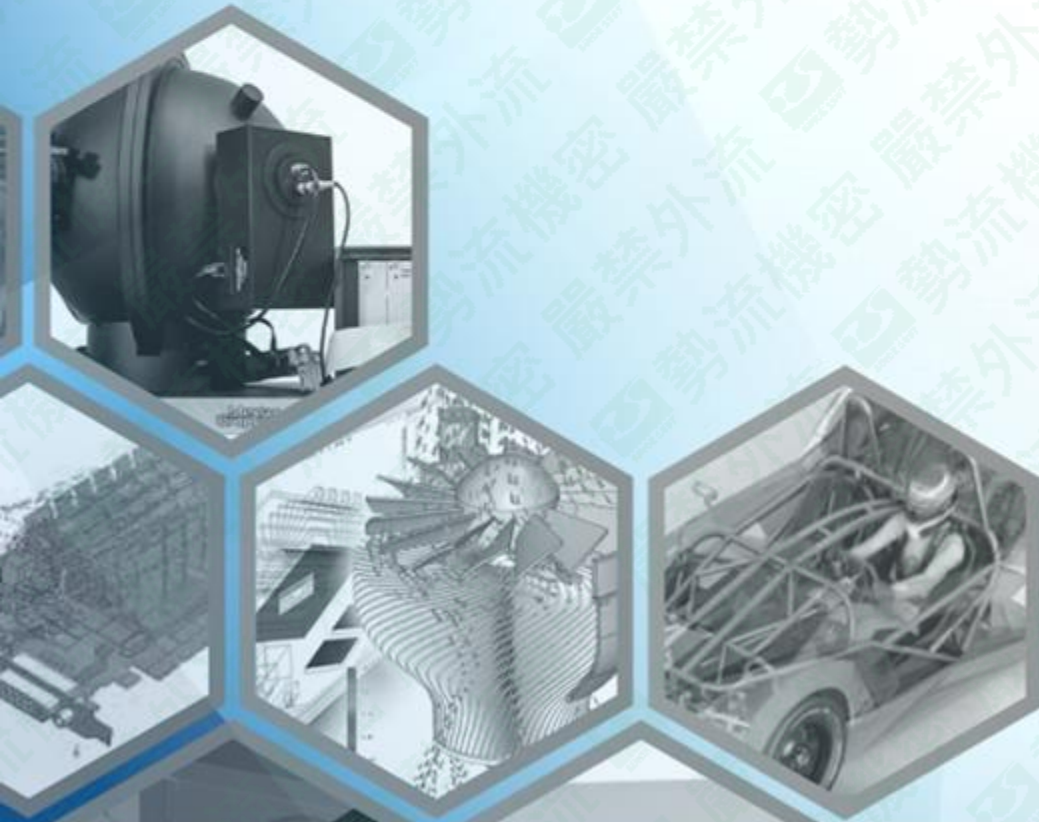
勢流科技

partner

SIEMENS

Digital Industries Software

Thanks 謝謝



-  Jim
-  jim@flotrend.com.tw
-  +886-2-27266269 ext:222
-  PID
-  北市信義區忠孝東路五段550號13樓

